

PRESSEMELDUNG

PRESS RELEASE30.11.2020 || Page 1 | 2

Technologien für FOPLP und IC-Substrate der nächsten Generation

EVATEC AG und Fraunhofer IZM arbeiten zusammen an den organischen IC-Substraten und Fan-Out Panel-Level Packaging- (FOPLP-) Technologien der Zukunft mit fortschrittlichen Dünnschichtätzlösungen für Panelformate bis zu 650x650 mm. Eine neue Anlage unterstützt diese Arbeit als Teil der Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland (FMD) in Berlin.

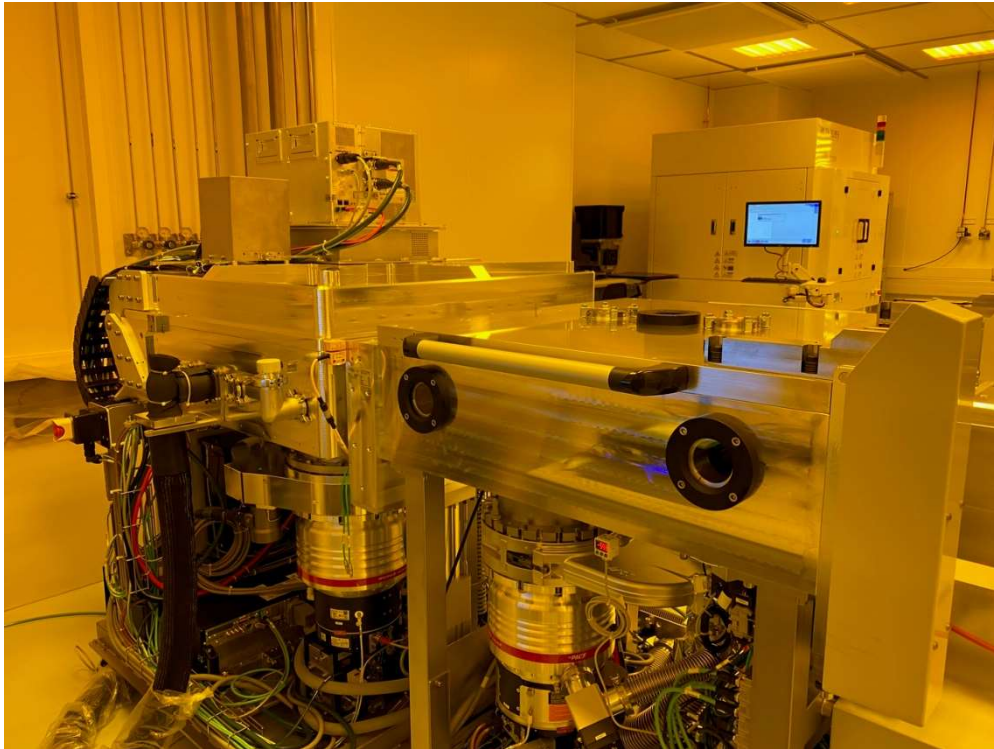
EVATEC AG, ein führender Anbieter für komplexe Dünnschichttechnologien und Prozesslösungen für innovative Packaging-, Halbleiter-, optoelektrische und photonische Anwendungen, hat ein Modell des neuen Clusterline 600 Panel-Level-Ätzesystems am Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM in Berlin installiert.

Das CLN600-System hält eine marktführende Stellung als spezialisierte Ätz- und Sputteranlage für FOPLP und IC-Substrate der nächsten Generation, die mit Panelformaten bis 650x650mm arbeiten kann. Die neue Anlage am Fraunhofer IZM bietet beispiellos genaue Ätzresultate selbst auf großformatigen Substraten sowohl bei direktem Argonätzen als auch bei reaktivem und tiefen reaktivem Ionenätzen (RIE und DRIE).

EVATEC AG behauptet seine Führungsposition im wachsenden Bereich des Panel-Level Packagings mit einem technischen Meisterstück, das wie gemacht für anspruchsvolle Prozess- und Technologieinitiativen wie das Panel-Level Packaging Consortium 2.0 scheint. Das CLN600-System ist Teil einer Aufrüstung des Maschinenparks am Fraunhofer IZM zum Start des PLC 2.0. Die nötigen Investitionen wurden durch die Förderung des BMBF für die Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland unterstützt (Fördernummern 16FMD01K, 16FMD02 und 16FMD03).

Das Fraunhofer IZM ist stolz auf die Anschaffung des innovativen CLN600-Systems und die strategische Zusammenarbeit mit EVATEC AG. „Wir sind gespannt auf die neuen Perspektiven und technischen Möglichkeiten, die uns dieses System im sehr dynamischen Bereich des Panel-Level Packagings bietet“, freut sich Lars Böttcher, Forscher am Fraunhofer IZM und Experte im PLP.

Editorial office**Susann Thoma** | Phone +49 30 46403-745 | susann.thoma@izm.fraunhofer.de |Fraunhofer Institute for Reliability and Microintegration IZM | Gustav-Meyer-Allee 25 | 13355 Berlin | www.izm.fraunhofer.de |



PRESS RELEASE

30.11.2020 || Page 2 | 2

Die neue CLN-600 Anlage am Fraunhofer IZM bietet spezialisierte Ätz- und Sputterfunktionen für innovative FOPLP und IC-Substrate der nächsten Generation. © Fraunhofer IZM / Evatec

Fraunhofer IZM: Invisible -but indispensable: nothing works without highly integrated microelectronics and microsystems technology. The basis for their integration into products is the availability of reliable and cost-effective packaging and interconnection technologies. Fraunhofer IZM, a world leader in the development and reliability assessment of electronic packaging technologies, provides its customers with customized system integration technologies at wafer, chip and board level. Research at Fraunhofer IZM also means making electronics more reliable and providing its customers with reliable information on the durability of the electronics.

The Institute is one of the thirteen members of the Research Fab Microelectronics Germany FMD – the prime provider of applied research, development, and innovations in micro and nano-electronics, supported by the Germany Federal Ministry of Education and Research. The FMD offers its diverse clients a single source for access to R&D services, applied solutions, and novel, but highly mature technologies. www.forschungsfabrik-mikroelektronik.de

Technical point of contact

Lars Böttcher | Phone +49 30 46403-643 | lars.boettcher@izm.fraunhofer.de |

Fraunhofer Institute for Reliability and Microintegration IZM | Gustav-Meyer-Allee 25 | 13355 Berlin | www.izm.fraunhofer.de |